

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2005-123569

(P2005-123569A)

(43) 公開日 平成17年5月12日(2005.5.12)

(51) Int. Cl. ⁷	F I	テーマコード (参考)
H01L 25/065	H01L 25/08	Z
H01L 21/3205	H01L 21/88	J
H01L 23/52	H01L 21/88	T
H01L 25/07	H01L 23/52	C
H01L 25/18		

審査請求 未請求 請求項の数 5 O L (全 8 頁)

(21) 出願番号 特願2004-187764 (P2004-187764)
 (22) 出願日 平成16年6月25日 (2004. 6. 25)
 (31) 優先権主張番号 特願2003-332935 (P2003-332935)
 (32) 優先日 平成15年9月25日 (2003. 9. 25)
 (33) 優先権主張国 日本国 (JP)

(71) 出願人 396026248
 ミナミ株式会社
 東京都府中市南町五丁目38番地32
 (74) 代理人 100073324
 弁理士 杉山 一夫
 (72) 発明者 村上 武彦
 東京都府中市南町五丁目38番地32 ミ
 ナミ株式会社内
 Fターム(参考) 5F033 MM30 PP26 PP27 PP28 VV07
 XX19

(54) 【発明の名称】 ウエハの印刷配線基板への実装方法

(57) 【要約】

【課題】 ウエハの両面を利用することができるようにする。

【解決手段】 ウエハ1に、上下の面に貫通するスルーホール2を設けると共に該スルーホール2の内面に絶縁層14を形成する。該ウエハ1の上下両面に再配線回路3、4を形成すると共に該再配線回路3、4を前記スルーホール2内において絶縁層14上に施したメッキ9により接続する。また前記再配線回路3、4上にはんだ等の導電材による熱応力緩和ポスト5、6を形成すると共に、該熱応力緩和ポスト5、6上にはんだバンプ7、8を形成する。そしてウエハ1のはんだバンプ7又は8を印刷配線基板11の配線回路12に接合する。

【選択図】 図3

